

Link do produktu: <https://www.gotronik.pl/xgsp30-pasta-lutownicza-niskotemperaturowa-183-20g-p-10426.html>



XGSP30 pasta lutownicza niskotemperaturowa 183°C 20G

Cena brutto	7,00 zł
Cena netto	5,69 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	MCH-XGSP30
Kod producenta	XGSP30
Producent	Mechanic

Opis produktu

XGSP30 pasta lutownicza niskotemperaturowa ołowiowa 183°C 20g



Ołowiowa pasta lutownicza Mechanic XGSP30 przeznaczona to lutowania elementów SMD, BGA. Pasta niskotemperaturowa topi się już w temperaturze 183°C. Produkt o dobrej lepkości, brak pęcherzyków oraz kulek lutowniczych. Produkt idealnie nadaje się do stosowania przy lutowaniu elementów SMD oraz BGA na płytach głównych telefonów, laptopów, reabilingu SMT oraz innych urządzeń. Pasta ma silną zdolność łączenia się z cyną, dobrą przewodność i dużą nośność cyny, co umożliwia brak przeróbek po nałożeniu kulek.



Parametry techniczne

- producent: Mechanic
- nazwa produktu: XGSP30
- pasta lutownicza
- pasta ołowiowa
- niskotemperaturowa - temperatura topnienia 183°C
- pojemność opakowania: 20g
- pasta składa się z tysięcy nanocząsteczek ułatwiających nanoszenie oraz lutowania
- dobra przewodność i duża łatwość cynowania
- przyjazna dla użytkownika, łatwa w aplikacji
- stop: Sn63/Pb37
- 63% cyna, 37% ołów
- wielkość cząsteczek: 20-38um
- pasta: IPX3
- do użytku przemysłowego, serwisowego
- **produkt przechowywać w temperaturze od 0 do 10°C**
- w przypadku gdy pasta jest zbyt twarda można dodać dodatkowo topnika

Oferta dotyczy zakupu 1szt. pasty XGSP30





More Detailed Photos:







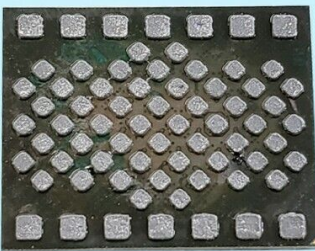
香港維修佬
MECHANIC

Room temperature leaded solder paste



Micro Soldering Paste

Before



After

